

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ  
**РАБОЧИЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР**

17467-88



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

# МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГОСТ 17467—88  
(СТ СЭВ 5761—86)

Издание официальное

20 коп. БЗ 11—88 829

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

**МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ**

Основные размеры

Integrated microcircuits. Basic dimensions

**ГОСТ****17467—88****(СТ СЭВ 5761—86)**

ОКП 63 0000

Дата введения 01.01.90

Настоящий стандарт распространяется на интегральные микросхемы в корпусах и устанавливает их габаритные и присоединительные размеры.

Стандарт не распространяется на микросхемы СВЧ диапазона.

Термины и определения соответствуют ГОСТ 17021—88 и приложению 1.

1. Размеры микросхем в корпусах должны соответствовать указанным на черт. 1—26 и в табл. 1—45.

Размеры микросхем приведены с учетом покрытий.

Буквенные обозначения размеров приведены в приложении 1.

2. Размеры микросхем приведены без учета крепления и специальных конструктивных элементов для дополнительного отвода тепла.

Размеры этих элементов указывают в стандартах или технических условиях на микросхемы в корпусах конкретных типов.

3. По форме проекции тела корпуса интегральной микросхемы на плоскость основания и расположению выводов корпуса подразделяют на типы и подтипы, указанные в приложении 2.

4. Указания о нанесении размеров в габаритных чертежах на конкретные конструкции микросхем приведены в приложении 3.

5. При разработке микросхем, размеры которых отсутствуют в настоящем стандарте, необходимо руководствоваться формулами, приведенными в приложении 4.

6. В технически обоснованных случаях для микросхем, не подлежащих по своим конструктивно-технологическим и техническим характеристикам для применения при автоматизированной сборке

аппаратуры по согласованию с потребителем допускается увеличение размеров  $Z_{\max}$  и  $Z_{\text{имакс}}$  при соблюдении следующих условий:  $Z \leq e$ ,  $e \leq Z \leq 2e$ ;  $2e \leq Z \leq 3e$  и т. д. при соответствующем увеличении габаритных размеров  $D_{\max}$  и  $E_{\max}$ .

7. Шаг позиций выводов и выводных площадок приведен в таблицах для микросхем конкретного типа корпуса.

Примечание. Для микросхем, поставляемых на экспорт, допускается применять шаг позиций выводов 1,27; 2,54 мм, при этом размеры микросхем  $D$ ,  $E$ ,  $G_E$ ,  $G_D$ ,  $e_1$ ,  $e_2$ , зависящие от шага, определяют по табл. 35—45, соответствующим СТ СЭВ 5761—81, и по формулам, приведенным в приложении 4.

8. Габаритные размеры деталей и сборочных единиц корпусов следует определять с таким расчетом, чтобы после сборки и герметизации микросхемы ее габаритные размеры не превышали значений, приведенных в табл. 1—45.

9. Каждому выводу присваивается номер его позиции. Пропуски рядов и отдельных выводов не регламентированы, при этом номер позиции вывода сохраняется.

10. Выводы в поперечном сечении должны быть круглой, квадратной или прямоугольной формы.

11. Выводы микросхем с повышенной мощностью рассеивания могут иметь:

для микросхем в корпусах 1-го и 2-го типов — диаметр описанной окружности для выводов с прямоугольным поперечным сечением до 1,3 мм и диаметр круглого поперечного сечения до 1,2 мм, при расстоянии между осями соседних в ряду выводов не менее чем 5,0 мм;

для микросхем в корпусах подтипа 32 — диаметр круглого поперечного сечения до 1,0 мм;

для микросхем в корпусах подтипов 41 и 42 — ширину рабочей части вывода до 1,25 и 2,5 мм при расстоянии между осями плоскостей симметрии соседних в ряду выводов не менее чем 2,5 и 5,0 мм соответственно и толщину вывода до 0,4 мм. По согласованию с потребителем допускается толщина вывода до 0,7 мм.

12. Ключ микросхемы полностью или частично должен быть расположен в заштрихованной области, указанной на черт. 1—19, таким образом, чтобы после установки микросхем на плату можно было определить позицию первого вывода.

Заштрихованная область, указанная на черт. 1—4, 7—10, 16, 17, 18, 19, условно показана со стороны плоскости основания.

13. Размеры, указанные в таблицах в скобках, в новых разработках деталей и сборочных единиц корпусов не применять, за исключением изделий, не предназначенных для автоматизированной сборки аппаратуры.

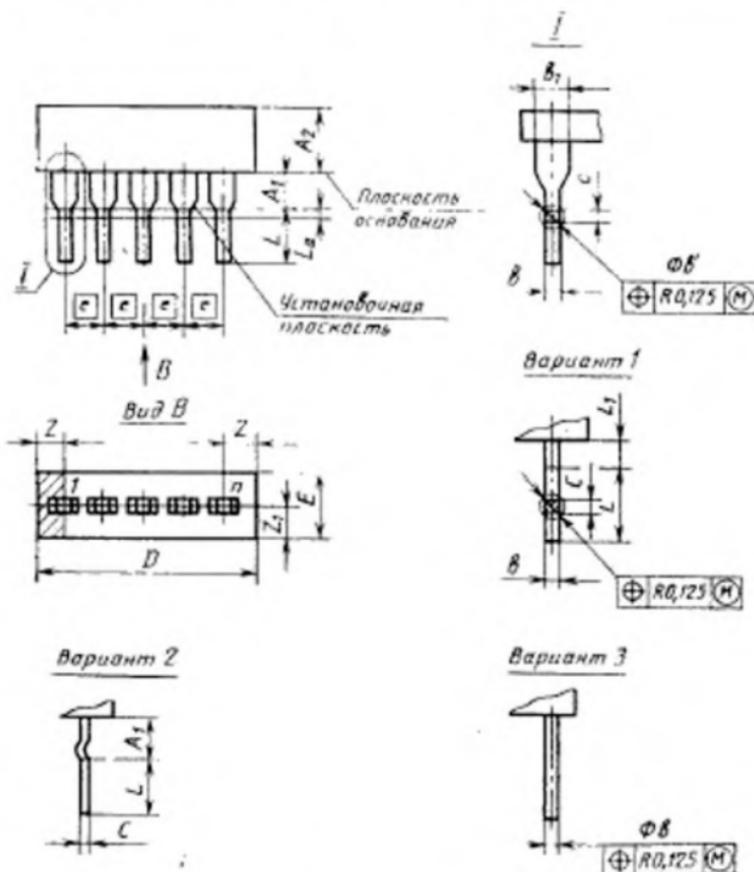
14. Конфигурация и размеры выводов микросхем в корпусах 1, 2 и 6-го типов в пределах размера  $A_1$  и выше установочной пло-

скости, а также выводов микросхем 1 и 3-го типов в пределах размера  $L_1$  не регламентированы и не контролируются.

15. Размеры интегральных микросхем, применяемых для автоматизированной сборки аппаратуры, по требованию потребителей допускается уточнять, что указывают в договорах на поставку.

16. Размеры микросхем в корпусах типа 1

16.1. Размеры микросхем в корпусе подтипа 11 должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1 и 2.



Черт. 1